

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국



(10) 국제공개번호
WO 2023/121037 A1

(43) 국제공개일
2023년 6월 29일 (29.06.2023)

- (51) 국제특허분류:
C09G 1/02 (2006.01) *C09K 3/14* (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/019314
- (22) 국제출원일: 2022년 12월 1일 (01.12.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2021-0186546 2021년 12월 23일 (23.12.2021) KR
- (71) 출원인: 주식회사 케이씨텍 (KCTECH CO.,LTD.) [KR/
KR]; 17599 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30,
Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 최보혁 (CHOI, Bo Hyeok); 18395 경기도 화성
시 동탄지성로 333, 108동 305호, Gyeonggi-do (KR). 공
현구 (KONG, Hyun Goo); 16336 경기도 수원시 장안
구 이목로 24, 126동 1403호, Gyeonggi-do (KR). 김지혜
(KIM, Ji Hye); 13567 경기도 성남시 분당구 양현로166
번길 20, 907동 1701호, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 무한 (MUHANN PATENT & LAW
FIRM); 06144 서울특별시 강남구 언주로 560, 8층,
Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국
내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역
내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, CV, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM),
유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME,
MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM,
ML, MR, NE, SN, TD, TG).



WO 2023/121037 A1

공개:
— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(54) Title: POLISHING SLURRY COMPOSITION

(54) 발명의 명칭: 연마 슬러리 조성물

(57) Abstract: The present invention relates to a polishing slurry composition, and more specifically to a polishing slurry composition for polysilicon polishing, the composition comprising: colloidal silica abrasive particles; a quaternary ammonium cationic monomer; and an acidic material.

(57) 요약서: 본 발명은, 연마 슬러리 조성물에 관한 것으로, 보다 구체적으로, 콜로이달 실리카 연마입자; 4급 암모늄 양이온성 모노머; 및 산성 물질,을 포함하는, 다결정실리콘 연마를 위한, 연마 슬러리 조성물에 관한 것이다.